板级射频电路开发



第八讲 半导体与晶体管

主讲: 汪 朋

QQ: 3180564167



01	半导体
02	二极管原理
03	双极晶体管BJT原理
04	场效应管FET原理
05	晶体管射频电路

半导体

Part

半导体

半导体

处于导体和绝缘体之间的一种介质,可以在不同条件下表现出导电和不导电的特性;

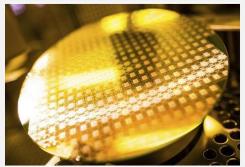
本征半导体

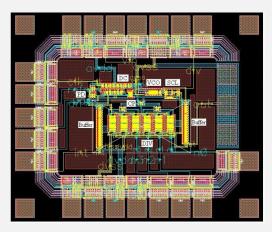
纯净的半导体,不含杂质,其紧靠本证激发载流子,导电性较差;

非本征半导体

掺杂杂质的半导体介质,主要有N型半导体和P型半导体。





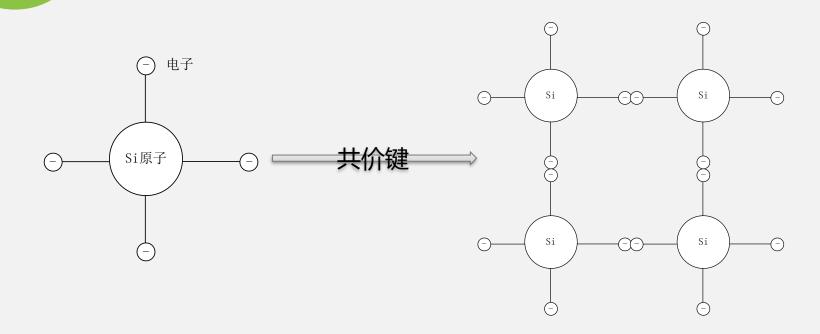


N型半导体

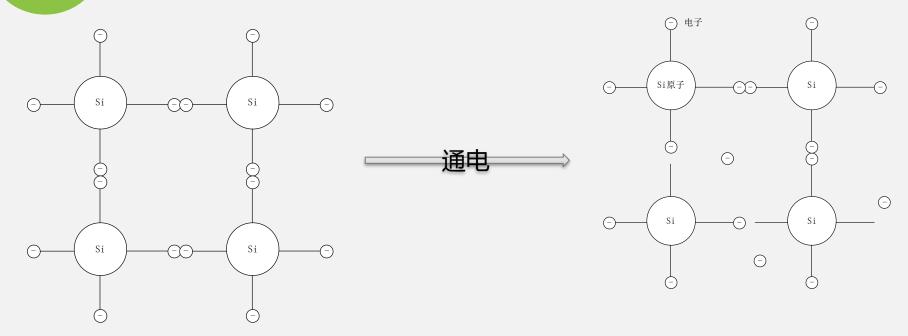
在本证半导体中掺入+5价元素(P, Sb等)的半导体。

N型半导体的微观原理:

以本证半导体硅Si为例分析



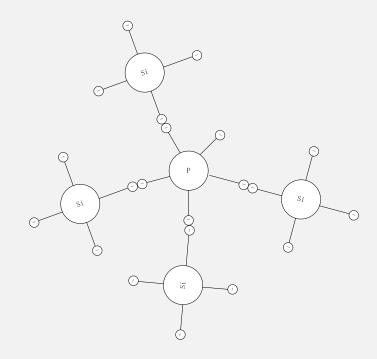
半导体导体原 理 全部硅原子的共价键通电后, 电子会吸收部分能量形成自由态, 移动的电子形成电流



N型半导体

<u>N掺杂</u>

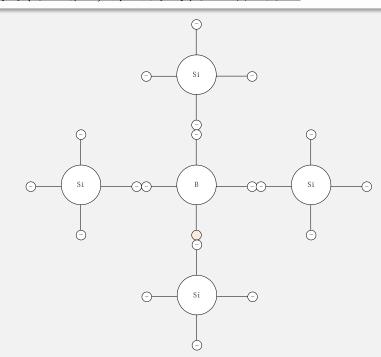
在纯硅的共价键中注入价电子为5的磷等元素, N掺杂将使半导体中多出一个电子, 且始终处于自由态。





P掺杂

在纯硅的五价键中注入价电子为3的镚等元素,由于B的价电子数为3,因此其一个手臂上会多出一个空穴,其相邻的电子可以随时移动将这个空穴补上,因此便形成了空穴的位运动。

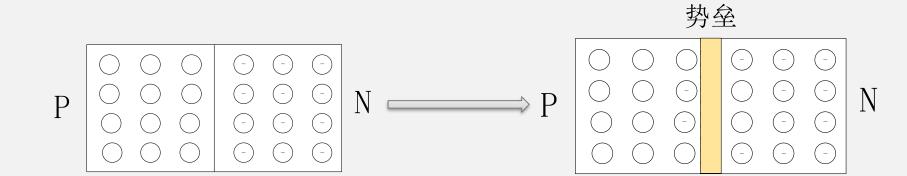


二极管微观原理

Part

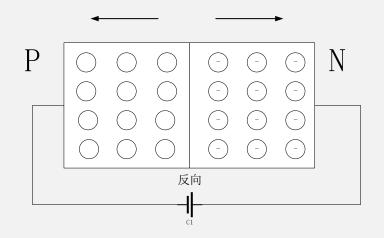
二极管原理

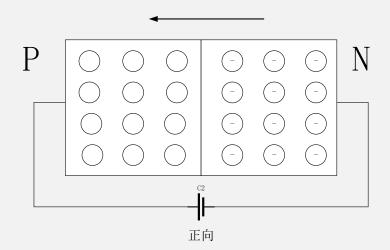
二极管自然状态



二极管原理

二极管通电状态



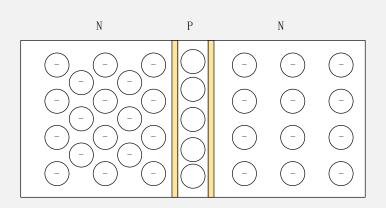


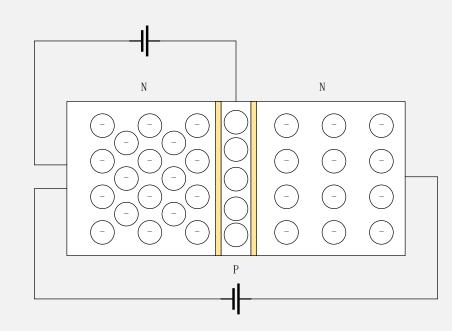
3 三极管BJT微观原理

Part

BJT原理

NPN三极管原理



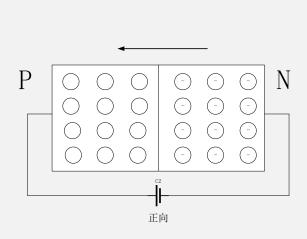


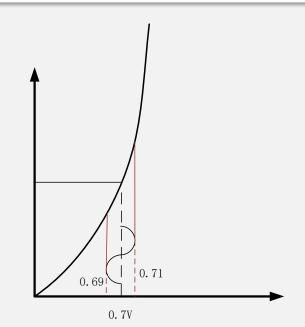
BJT原理

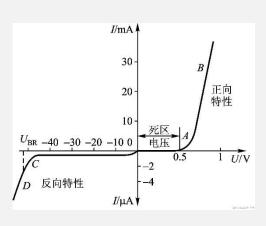
NPN三极管实现信号放大的原理

二极管电流和电压的关系

假如在正向施加0.01V的交流信号,正向偏置电压为0.7V

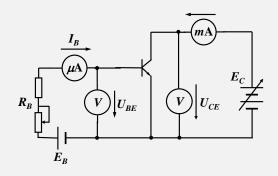


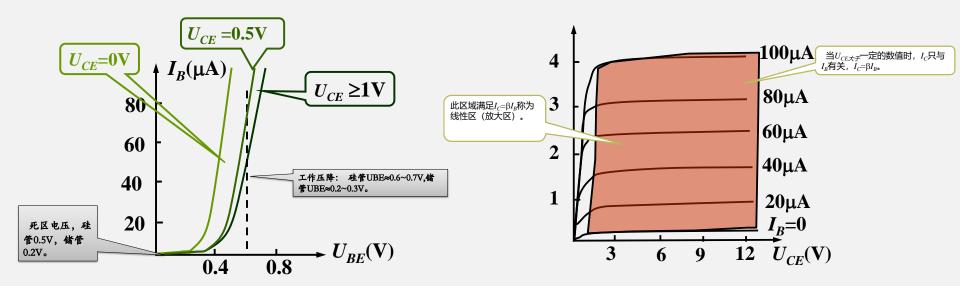




BJT原理

NPN三极管实现信号放大的原理





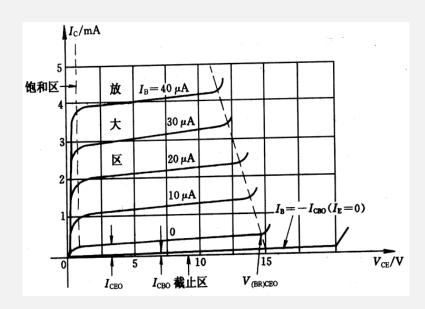
BJT原理

NPN三极管输出伏安特曲线

放大区:发射结正偏,集电结反偏,即: Ic=βIb, $IL_AIc=β_AIb$;

饱和区:发射结正偏,集电结正偏,即: Uce<Ube, βIb>Ic, Uce≈0.3V

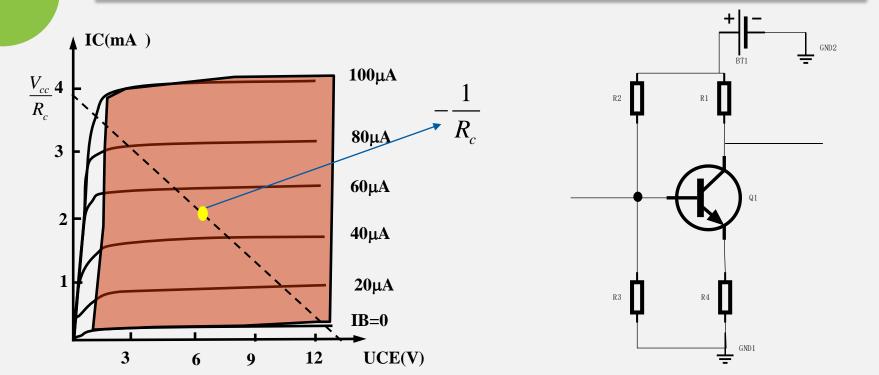
截止区: Ube< 死区电压, Ib=0, Ic=Ice ≈ 0



BJT原理

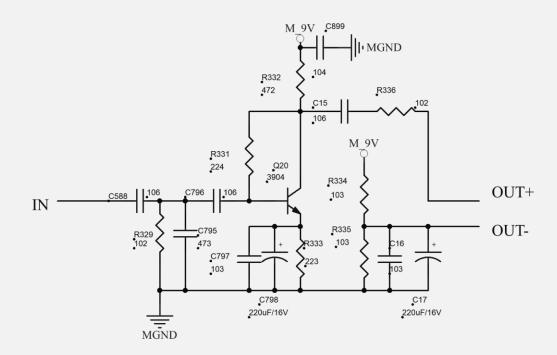
静态工作点

确定放大电路的电压和电流的静态值,选取合适的静态工作点可以防止电路产生非线性失真。



BJT原理

应用电路



Fart 场效应管微观原理

场效应管

场效应管和三极管

[1] 三极管通过电流的大小控制输出,输入要消耗功率。场效应管是通过输入电压控制输出,不消耗功率;

[2] 场效应管的优点

微观上只有一种载流子运动,输入电阻高、噪声小、功耗低、没有二次击穿现象、安全工作区域宽、受温度和辐射影响小。

[3] 场效应管类型

N沟道耗尽型和增强型, P沟道耗尽型和增强型

耗尽型原理: 导通沟道从有到无的控制; 增强型原理: 导通沟道从无到有的控制。











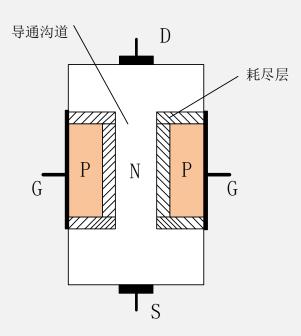


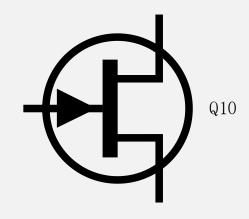


JFET

耗尽型JFET

N沟道结型场效应管(JFET)的结构如图,它是在N型半导体硅片的两侧各制造一个PN结,形成两个PN结夹着一个N型沟道的结构。两个P区连接在一起为栅极G,N型硅的一端是漏极D,另一端是源极S。

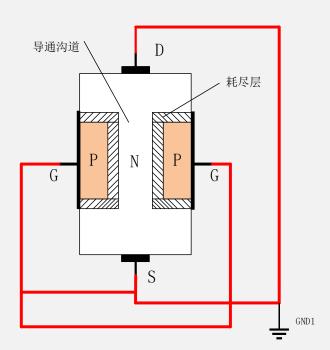




JFET

耗尽型N沟道JFET原理

 $\underline{\text{SU}_{GS}}=0$,导通通道最宽,此时在 $\underline{\text{U}_{DS}}\neq 0$ 时, $\underline{\text{I}_{DS}}$ 最大。



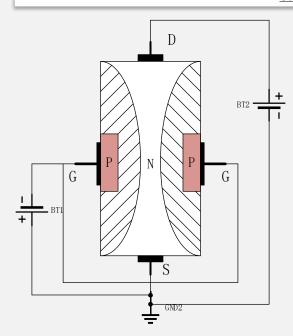


耗尽型N沟道JFET原理

栅极-源极电压的影响

 $\underline{LU}_{\mathrm{GS}}$ 增加负电压后, $\underline{LU}_{\mathrm{GS}}$, $\underline{LU}_{\mathrm{GS}}$ 增加负电压, $\underline{LU}_{\mathrm{GS}}$, $\underline{LU}_{\mathrm{GS}}$ 增加负电压, $\underline{LU}_{\mathrm{GS}}$

使导电沟道刚刚消失的临界电压UGS成为夹断电压UGS(off)。

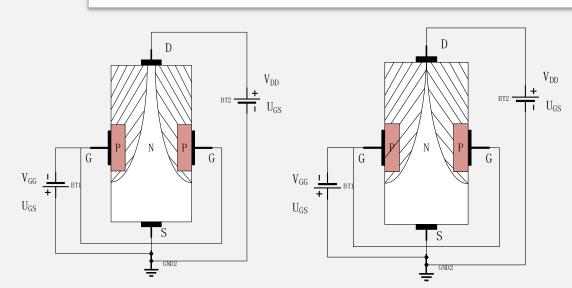


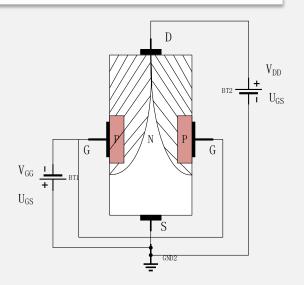


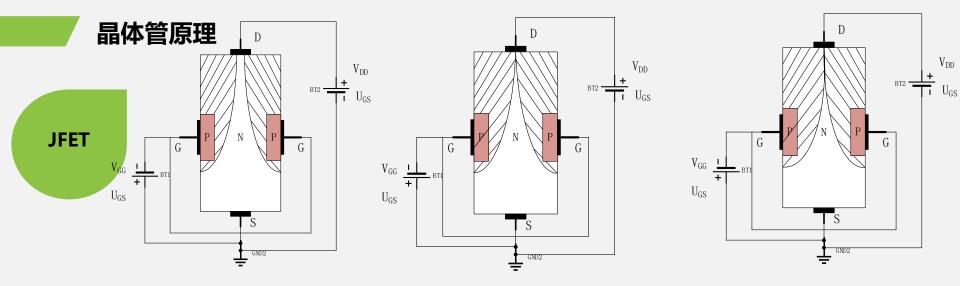
耗尽型N沟道JFET原理

漏源电压UDS对漏极电流ID的影响

- [1] UGD=VGG-VDD, 若UGD>UGS(off), 如果UGS> UGS(off), 且UGS(off)恒定,则VDD增加时, ID增加;
- [2] 如果UGD=UGS(off), 沟道处于预夹断;
- [3] 如果UGD<UGS(off),则预夹断区域变长,电子运动的阻力增加;
 - 此状态下, ID将保持恒定。







总结: [1] 沟道的大小受到UGS和UDS的影响;

- [2] 沟道内的电流是否阻断只受UGS的影响,当UGS < Uoff时,沟道彻底阻断,此时再无电流通过,ID=0;
- [3] 只要Ugs>Uoff, 那么都不会完全阻断, 此时增加UDS不会导致沟道阻断, 始终有电流可以通过;
- [4] Ugs-UDS < Uoff,只要确保UGS > Uoff,那么此时沟道到达电流饱和状态,处于恒定,不再受电压UDS的影响,

JFET

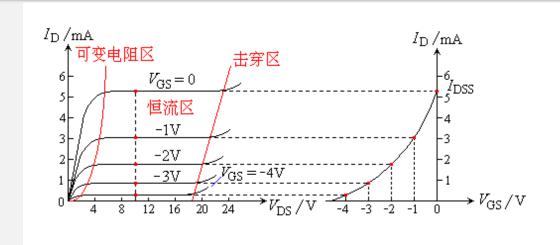
耗尽型N沟道JFET原理

场效应三极管的特性曲线有两条,一是转移特性曲线,二是输出特性曲线。

[1] 输出特性分成可变电阻区(线性区)、恒流区(饱和区)和夹断区。 $i_{\mathrm{D}} = f(u_{\mathrm{DS}})$ $U_{\mathrm{GS}} = 常数$

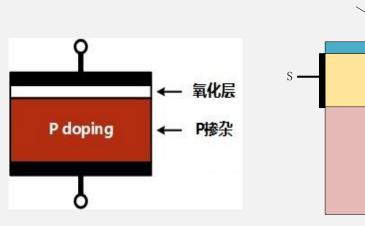
[2] 转移特性曲线

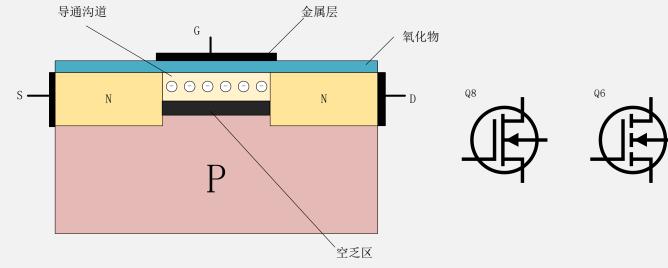
$$i_D = I_{DSS} (1 - \frac{u_{GS}}{U_{GS(off)}})^2$$





MOSFET全称Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor,即金属氧化物半导体场效应晶体管; 相对于JFET,MOSFET增加了一个氧化物绝缘体,因此可以获得较大的输入阻抗,且UGS的电压可以大于 0,MOSFET可以用于V波段,U波段以上的频段,但相对于JFET而言,MOSFET自身的噪声更大。

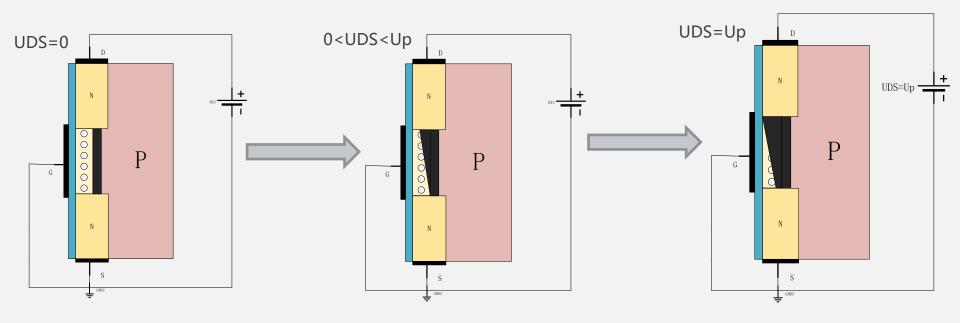






耗尽型MOSFET工作原理

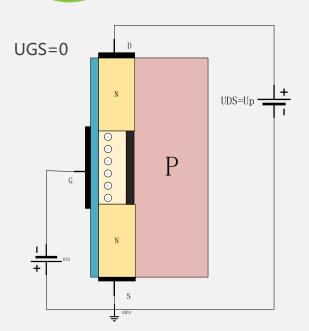
当UGS=0时,随着UDS的增加,导电通道逐渐变窄,当UDS=Up(夹止电压),通电沟道处于预夹断状态,此时IDS达到了最大值,此时继续增加UDS,IDS仍保持不变。

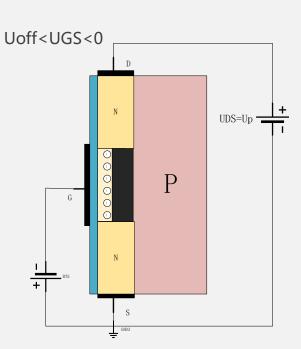


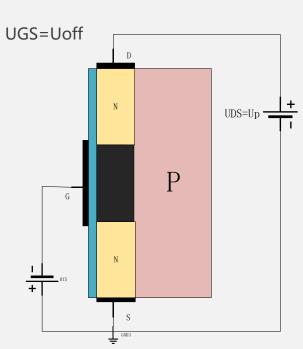


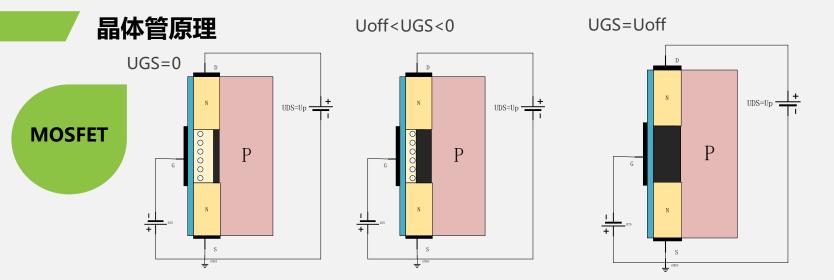
耗尽型MOSFET工作原理

当UGS<0时,随着UGS的降低,导电通道逐渐变窄,当UGS=U(off),通电沟道关闭,此时IDS=0









总结:

- [1] 导通通道完全关闭有Ugs控制,当Ugs<Uoff,通断关闭,此时没有电流可以通过,IDS=0;
- [2] 当Ugs>Uoff,通道是打开的,此时电流ID的大小受UDS控制,

但是ID的不会无限增加,当UDS=Up时,通道处于预夹断状态,此时电流值ID进入恒定,不再受UDS的影响;

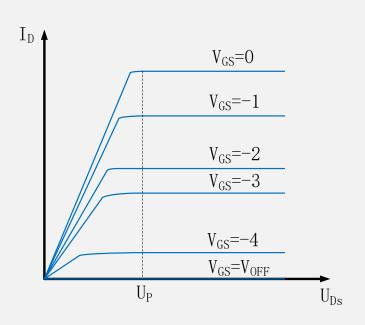
[3] Uds和Ugs是相互独立,二者共同影响电流ID的大小,但: Ugs越小,UDS对应的夹止电压Up就越低,也就是说,Ugs越小,随着UDS的增加,越快进入恒流区。 说明:

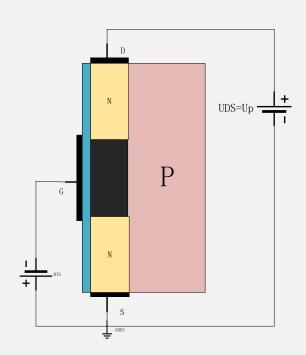
只要Ugs>Uoff, 通道内就有电压通过。

Ugs < Uoff对应的通过关闭和UDS=Up对应的预夹断状态不一样的。

MOSFET

耗尽型MOSFET伏安特曲线

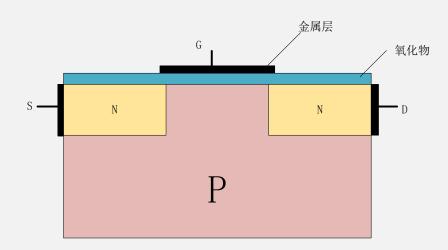






增强型MOSFET工作原理

增强型MOSFET默认状态下不存在导通通道,需要通过栅极的电压进行控制,使形成导通通道。

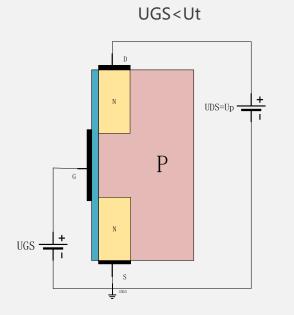


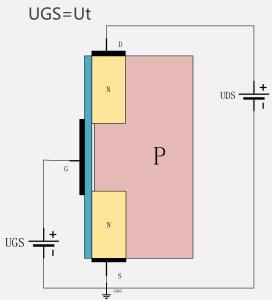


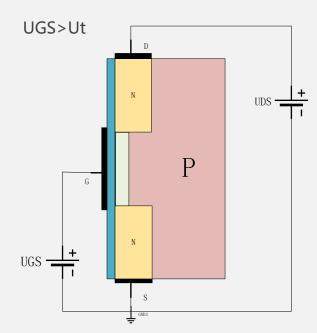


增强型MOSFET通道产生方法

当UDS=0时,在栅极和源极施加正电压,当电压值UGS>Ut(阈值电压)时,逐渐形成导通通道





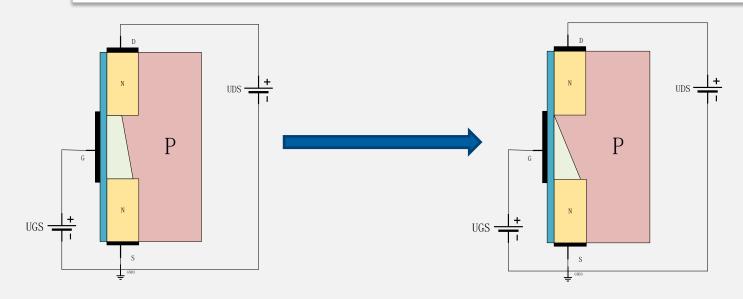


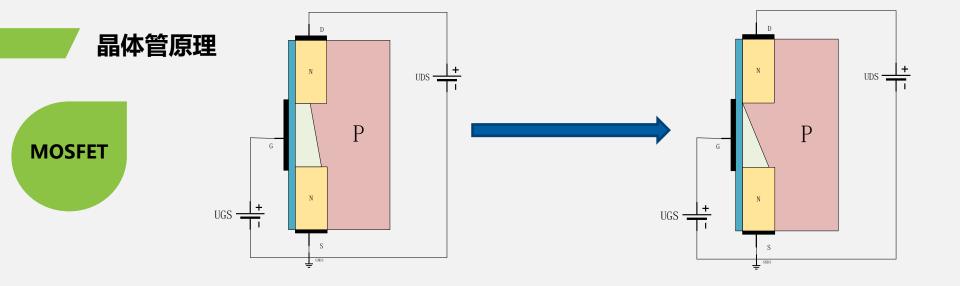


增强型MOSFET通道产生方法

当UDS>0时,在栅极和源极施加正电压,当电压值UGS>Ut(阈值电压)时,导通通道将受到UDS和UGS的共同影响,主要由栅极金属到沟道的电场强度影响。

当UGS为大于Ut的恒定值,随着UDS的增大,沟道会由于电场的不均匀(G极金属到沟道的电势差)的影响, 沟道在D极会进入临界,此时电流ID达到最大值,继续增加UDS,ID保持稳定,MOSFET进入饱和状态。





总结:

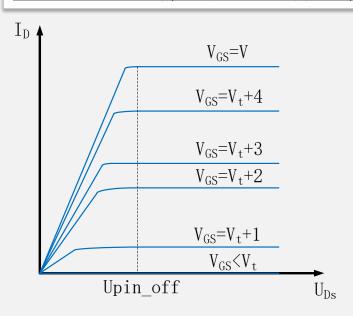
- [1] 导通通道是由Ugs的电压控制的,Ugs>Ut时,开始产生通道,D和S导通;
- [2] Uds能够控制沟道宽度的前提是,必须先要有UGS控制产生通道以后,因为Uds控制通道的方式是将沟道由宽到窄进行控制,因此得现有沟道;
- [3] 当UDS逐渐增加时,沟道会慢慢进入预夹断状态,此时对应的UDS的值就为夹止电压Up,从此时开始,电流IDS将保持恒定,不再受UDS的影响

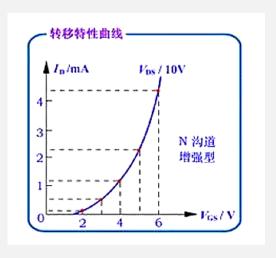


增强型MOSFET伏安特曲线

当UDS>0时,在栅极和源极施加正电压,当电压值UGS>Ut(阈值电压)时,导通通道将受到UDS和UGS的共同影响,主要由栅极金属到沟道的电场强度影响。

当UGS为大于Ut的恒定值,随着UDS的增大,沟道会由于电场的不均匀(G极金属到沟道的电势差)的影响,沟道在D极会进入临界,此时电流ID达到最大值,继续增加UDS,ID保持稳定,MOSFET进入饱和状态。



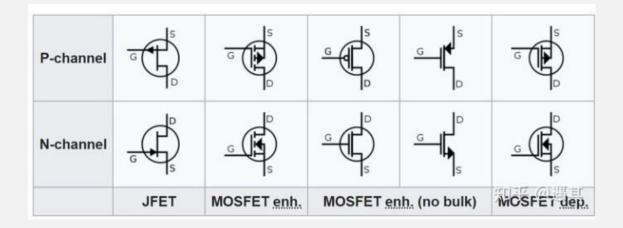


Part 5

晶体管应用电路

应用电路

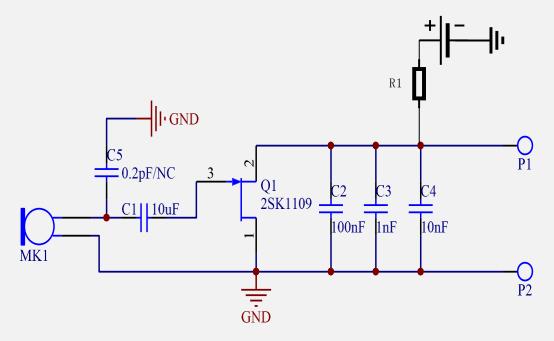
晶体管原理图符号



应用电路

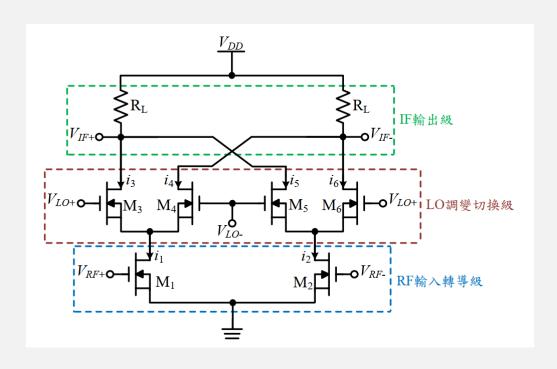
咪头音频内置放大器





应用电路

混频器应用



THANK YOU!!